

## 電子部品の外観検査に最適な卓上検査装置 「3D-Eye スキャナー計測検査モデル」発売

日本エフ・エーシステム株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：小國勇）は、2012年3月上旬、卓上型3D形状計測装置「3D-Eyeスキャナー計測検査モデル」を発売します。

「3D-Eyeスキャナー」は、部品の3次元形状測定を行うための簡易型卓上計測装置です。光切断法に基づき、幅の広いレーザ光源でワークを一括スキャンする測定方式のため、短時間での3D形状計測が可能です。

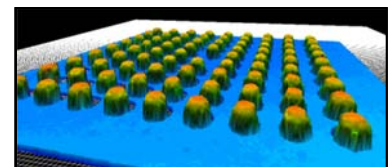
今回発売する「計測検査モデル」は、ワークの大きさ（高さ・体積等）を測る従来の計測装置に検査対象専用のソフトを追加した検査装置です。OK/NG判別が可能となり、研究開発用途のみならず、他の計測装置では難しい少量製造ラインでの3D外観検査に対応できます。

「BGA（Ball Grid Array）」の bumps 高さ・直径・体積・コプラナリティーなど、半田接合性の検査を行う「BGA bumps 計測検査モデル」をはじめ、「PCB（Printed Circuit Board）用基材計測検査モデル」、「半田フィレット計測検査モデル」、「膜厚分布計測検査モデル」など、お客様の検査対象に応じたカスタマイズを行います。

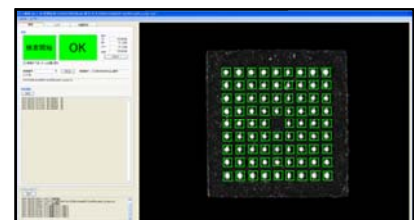
今後も日本エフ・エーシステムは産業用画像検査装置のシステムインテグレータとして、高速・高精細の画像処理技術を幅広くご提供していきます。



■ 3D 画像



■ 検査画面例



■基本仕様	1軸仕様	2軸仕様	
		標準タイプ	ワイドタイプ
測定範囲(X×Y)	75mm×15mm	75mm×60mm	125mm×105mm
測定視野(スキャン幅)	15mm		
Z軸測定可能段差	1mm		
Z軸ストローク(フォーカス)	50mm		
測定分解能	X軸:10μm Y軸:10μm Z軸:0.89μm		
最大駆動速度	100mm/sec		
PC・モニター	OS:Windows 7 Professional、グラフィックボード DirectX対応		
寸法  (W×D×H、Z軸最下端時、 ケーブル除く)	320×250×375mm	320×255×405mm	400×350×425mm

■国内販売数目標 (2012年)

30台

■主要販売先

半導体業界、電子部品業界

■会社概要

日本エフ・エーシステム株式会社 (2011年12月現在)

商号：日本エフ・エーシステム株式会社

所在地：東京都品川区西五反田4-32-1 東京日産五反田ビル10F

設立：1991年6月12日

代表取締役：小國 勇

資本金：80,000千円

事業内：産業用画像機器の開発、設計、製造、輸出入、販売及びコンサルタント業務

従業員数：14名

親会社：オプテックス・エフエー株式会社 (100%出資)

---

【本件に関するお問合せ先】

日本エフ・エーシステム株式会社

技術営業部 小松 健司 (E-mail: sales@jfas.co.jp)

〒141-0031 東京都品川区西五反田4-32-1 東京日産五反田ビル10F

TEL: 03-5740-7521 FAX: 03-5740-7524

URL: <http://www.jfas.co.jp/>

オプテックス・エフエー株式会社 【JASDAQ: 6661】

総務課 広報IR担当 伊藤 誠 (E-mail: m-ito@optex-fa.com)

〒600-8815 京都市下京区中堂寺粟田町91 京都リサーチパーク9号館5F

TEL: 075-325-2930 FAX: 075-325-2931

URL: <http://www.optex-fa.jp>